

Chemicals contained in products

Package-type

Epson Package name; **PBGA1UC256 / Halogen free**

JEITA Package name; **(P-LBGA-0256-1717-1.00)**

Solder ball Type; **Lead(Pb) Free**

Weight; **0.60 [g] ※1**

Part	Subpart	Subpart weight [mg]	Substance name	CAS No.	Content ※2		Application
					[mg]	[ppm]	
チップ	ICチップ	19.9	シリコン	7440-21-3	19.9	999914	主成分
			ホウ素	7440-42-8	0.00004	2	ドーパント
			無機リン	7723-14-0	0.0001	5	ドーパント
			アルミニウム	7429-90-5	0.0004	20	配線材
			ヒ素 ※3	7440-38-2	0.0001	5	ドーパント
			フッ素 ※3	7782-41-4	0.00004	2	ドーパント
			チタン ※3	7440-32-6	0.0004	20	配線材
			タングステン ※3	7440-33-7	0.0006	30	配線材
			コバルト ※3	7440-48-4	0.00004	2	配線材
PKG	保護膜	0.40	ポリイミド	-	0.40	1000000	保護膜 ※4
			回路基板	-	-	-	-
	回路基板	124.04	ガラスクロス	-	21.80	132000	強化材
			無機フィラー	-	5.00	66000	充填剤
			エポキシ樹脂	-	24.40	164300	主剤
			アクリレート系樹脂	-	7.20	85000	主剤
			顔料	-	3.20	49300	添加剤
			有機フィラー	-	0.42	3400	充填剤
			ヒ素	7440-38-2	0.12	85	耐熱性向上
			クロム化合物	-	0.004	14	耐熱性向上
			銅	7440-50-8	52.00	419901	銅箔(パターン配線)
			ニッケル	7440-02-0	7.90	64000	メッキ
			金	7440-57-5	2.00	16000	メッキ
	ダイアタッチ材	8.70	エポキシ樹脂	-	5.90	670000	接着剤
			アクリル樹脂	-	2.80	330000	接着剤
	半田ボール	103.68	錫	7440-31-5	99.30	957500	半田成分
			銀	7440-22-4	3.60	35000	半田成分
			銅	7440-50-8	0.78	7500	半田成分
	ボンディングワイヤー	6.60	金	-	6.60	1000000	導体材
			モールド樹脂	-	-	-	-
	モールド樹脂	336.37	エポキシ樹脂	-	16.80	50000	主成分
			シリカ	60676-86-0/-	293.70	873000	充填材
			カーボンブラック	1333-86-4	0.67	2000	樹脂着色剤
			硬化剤(フェノール樹脂等)	-	16.80	50000	硬化剤
			有機リン化合物	-	1.70	5000	硬化促進剤
			その他	-	6.70	20000	添加剤

化学物質の情報について

※1 パッケージの重量は、内蔵するチップのサイズ等、個別のIC仕様により多少異なる場合があります。

※2 含有データは、製品への意図的添加及び各サプライヤーからの情報に基づき算出された値であり、保証値ではありません。

従って、実測値はこのデータと多少異なる場合があります。

※3 これらの物質は、内蔵するICチップの仕様により、含有する場合としない場合があります。

※4 個別の機種により保護膜を使用しない場合があります。